



スーパーエンブラ・複合/コンパウンド技術開発

プロセスエンジニア（半導体）のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

非公開

Job ID

1488556

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

6 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:00

Holidays

【有給休暇】初年度 14日 3か月目から 完全週休2日制、夏季休暇、年末年始、慶弔、育児・介護休暇制度、有給休暇：年次有給22...

Refreshed

November 21st, 2024 22:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2238900】

■業務内容

当社では、今後の社会動向に対して、高機能かつ環境適用可能な材料の開発を進めています。特に、スーパーエンブラ樹脂、エンブラ樹脂等（バイオエンブラ、生分解性材料も含む）の材料設計やそれらを用いた用途開発、マーケティングを担っていただきます。

■具体的な担当業務

スーパーエンブラ樹脂、エンブラ樹脂等の材料設計（配合、成形、物性評価）。本材料設計を満たすための成形、評価技術の開発、また要となる界面制御や劣化機構解明といった基盤技術の構築メカニズム解明を行っていただきます。開発を進める材料の顧客提案やマーケティングも担っていただきます。

■ポジション・立場：リーダー層（自ら研究開発を進めながら、若手研究員を引張って頂き、リーダーとして役割も期待しています）

Required Skills

【必須】

- ・化学メーカーや化学系加工設備メーカーで成形、評価技術開発、また用途開発を推進してきた中堅技術者
- ・特に材料開発の要となる成形、評価といった基盤技術、材料設計案を構築できる人材
- ・経験年数：5～10年程度
- ・英語の文章を読んで理解し、簡単なメールの作成が可能な程度の英語力

【尚可】

- ・外部協創（産産、産学連携）の経験があり、自らテーマ提案や開発した材料のマーケティングや顧客評価推進の経験のある方。
 - ・ある程度日常会話が可能 目安としてTOEIC600点程度以上
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします